

Produktbeschreibung

- 100% nagelneu und hohe Qualität!!
- Kolophonium-Flussmittel wird verwendet, um das Löten zu erleichtern.
- Es reinigt und verhindert die Oxidation von Metallen, wodurch Lötmittel starke, lang anhaltende mechanische und elektrische Verbindungen eingehen kann.
- Es wirkt auch als Netzmittel und erhöht den Lotfluss und die Effizienz des Lötprozesses.
- Perfekt für Mobiltelefone, PC-Karten und andere hochentwickelte elektronische Flussmittelschweißgeräte.

Spezifikationen

Produkt: BST-706
Schmelzpunkt: 138 °C
Gewicht: 500 g
Zutaten: Sn99%, Cu0.7%, Ag0.3%

SOLDER PASTE

Lead-free medium temperature

BEST
倍思特
SOLDER PASTE

MODEL: BST-706
Alloy: Sn42/Bi58
Shelf Life: 6 months
Net Weight: 500g

PRECISION ELECTRONIC REPAIR
BEST
倍思特
SOLDER PASTE
BGA植锡膏

- Low residue / 低残留物
- Cold storage / 低温存储
- Mid-melting point / 中温熔点
- Even solder joints / 焊点均匀

CE
MADE IN CHINA

500g

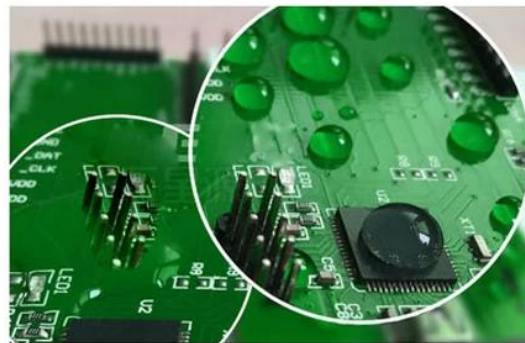
Low residue / Rapid welding / lead free / Solder spot bright

Product Usage

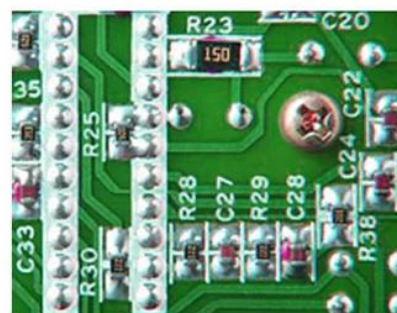
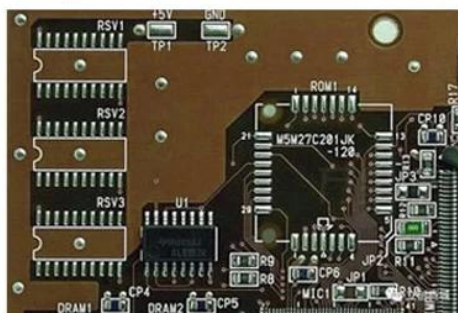


MODEL	BST-706
SHELF LIFE	6 months
INGREDIENT	Sn42/Bi58
WEIGHT	500g
MELTING POINT	138°C

Having a large insulation resistance does not corrode the PCB, and the requirements for no-cleaning can be achieved.



High impedance, full and bright solder, low residue

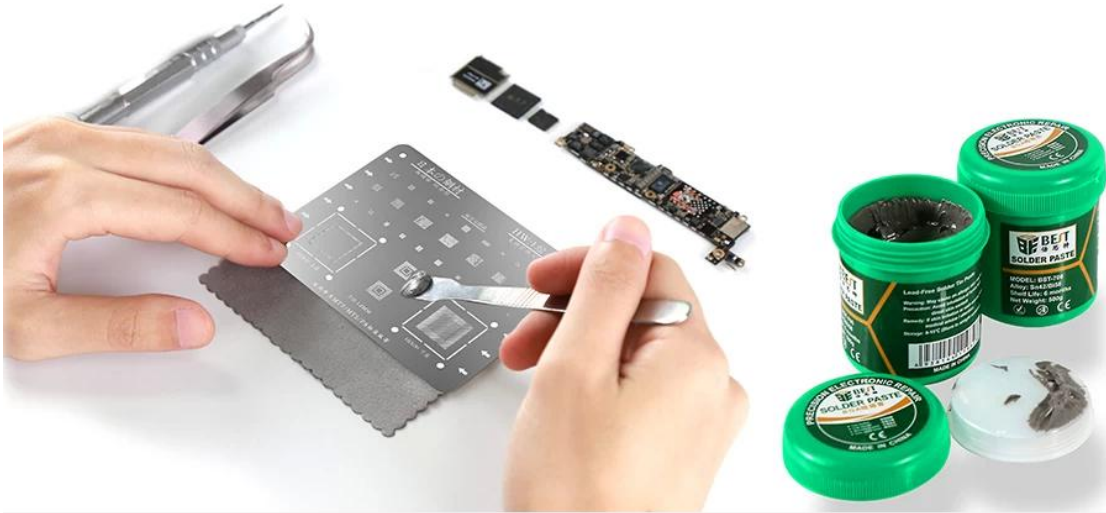


Welding requirements for a wide range of products



TESTING EFFECT

UNIFORM SOLDER JOINT
MEDIUM TEMPERATURE MELTING POINT



PRODUCT SIZE



63.0MM



52MM

75MM

